

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 4 月 28 日(28.04.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/048765 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) *C08L 83/04* (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01) *H01L 23/29* (2006.01)
C08L 23/26 (2006.01) *H01L 23/31* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/006011
- (22) 国際出願日: 2010 年 10 月 7 日(07.10.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-241427 2009 年 10 月 20 日(20.10.2009) JP
特願 2010-070700 2010 年 3 月 25 日(25.03.2010) JP
特願 2010-102429 2010 年 4 月 27 日(27.04.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKE-LITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田部井純一(TABEI, Junichi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 速水進治(HAYAMI, Shinji); 〒1410031 東京都品川区西五反田 7-9-2 五反田 T G ビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

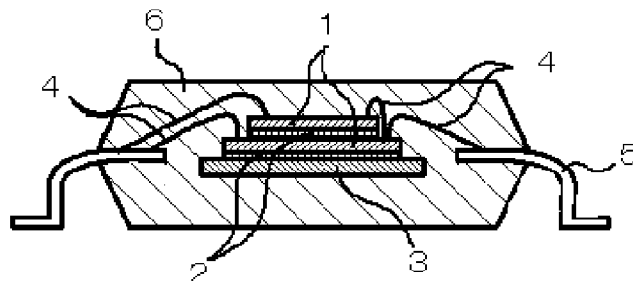
添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: EPOXY RESIN COMPOSITION FOR SEMICONDUCTOR ENCAPSULATION, SEMICONDUCTOR DEVICE, AND RELEASE AGENT

(54) 発明の名称: 半導体封止用エポキシ樹脂組成物、半導体装置及び離型剤

[図1]



(57) Abstract: The disclosed epoxy resin composition for semiconductor encapsulation contains (A) an epoxy resin, (B) a hardening agent, (C) an inorganic filler, and a release agent. The release agent contains (D) a compound having a copolymer, formed of an α -olefin having a carbon number of 28-60 and a maleic anhydride, esterified with a long chain aliphatic alcohol having a carbon number of 10-25.

(57) 要約: 半導体封止用に用いるエポキシ樹脂組成物は、(A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤、(C) 無機充填材、及び離型剤を含有し、前記離型剤が (D) 炭素数 28~60 の α -オレフィンと無水マレイン酸の共重合体を炭素数 10~25 の長鎖脂肪族アルコールでエステル化した化合物を、含有する。

WO 2011/048765 A1